

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 吉澤六朗
講演企画委員長 有門経敏

2026 年度 9 月度フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。2026 年 9 月度フォーラムの開催案内をご案内いたします。今年から講演件数を 4 件以上に増やし、半導体のみならず半導体のアプリケーションも含めて幅広く情報を提供致しております。今年度第 3 回目は半導体のイノベーションから半導体工場の SDGs/BCP、さらにはインド半導体産業を取り上げました。それぞれに専門分野を詳しく解説して頂きます。また、講演件数の増加に伴い、従来無料であった会員（個人会員、準会員、賛助会員）の方々からも若干の参加費をいただくことに致しました。会員の皆様にはなにとぞご理解をお願い申し上げます。

記

1. 開催日時

2026 年 9 月 28 日（月） 13：00～19：00

2. 開催場所

林野会館（+オンライン）

所在地：〒112-0012 東京都文京区大塚 3-28-7

最寄駅：地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩 7 分

3. プログラム（講演時間には Q&A 10 分を含む）

13：00～13：50（50 分）『イノベーションをいかに取り戻すか』

オルバイオ(株) 山口栄一氏

13：50～14：40（50 分）『もはや待ったなし — エネルギー制約へ挑む BBCube™』

Large-Scale 3DI using WOW/COW Hybrid Processes』

東京科学大学 大場隆之氏

14：40～14：50（10 分）休憩

14：50～15：40（50 分）『Green Innovation, Sustainable Growth』

～半導体の未来に向けた Winbond の ESG 戦略』

ウインボンドエレクトロニクス(株) 矢野勝氏

15：40～16：30（50 分）『半導体製造工場の安全、防災を含む BCM 取組と BCP 対策』

キオクシア(株) 池内徹氏

16：30～17：10（40 分）『インド市場の具体的進出方法、「SEMICON India 2026」報告』

NPO 法人 日印ビジネスビューロー／日印半導体コミッティー（JISC） 安井重麿、穂谷宜親氏

17：20～19：00 懇親会（林野会館）

4. 講演内容

(1) 『イノベーションをいかに取り戻すか』

講師：オルバイオ(株) 山口栄一氏

概要：日本が 21 世紀に入って滑り落ちるように凋落した原因は、1990 年代後半にほぼすべてのサイエンス型企業が研究から撤退したことに端を発する。この 30 年に及ぶ科学とイノベーションの同時危機を救うために、どうすれば良いのか？ 本講演ではイノベーションの源泉に立ち返って、イノベーションの構造を明らかにする。第一のイノベーションの構造は「創発 (abduction)」である。この重要性を示すために、窒化ガリウム半導体の事例研究を行なう。第二のイノベーションの構造は「回遊 (transilience)」である。これによって 1990 年代に米国が如何にして回遊型のイノベーションに基づく新産業を社会に定着させたかを明らかにする。最後に、私自身のバイオ産業への挑戦について触れ、半導体物理学者の「回遊」の事例研究としたい。

講師略歴：

1979 年に東京大学大学院理学系研究科物理学専攻を修了し電電公社に入社
1984 年～1985 年 米国ノートルダム大学客員研究員
1986 年～1998 年 NTT 基礎研究所 主任研究員・主幹研究員
1993 年～1998 年 仏国 IMRA Europe 招聘研究員
1998 年～2003 年 経団連 21 世紀政策研究所 主席研究員・研究主幹
2003 年～2014 年 同志社大学大学院教授
2008 年～2009 年 英国ケンブリッジ大学クレアホール客員フェロー
2014 年～2020 年 京都大学大学院教授
2018 年にオルバイオ株式会社を創業
2020 年～現在 京都大学 名誉教授
2020 年～2023 年 立命館大学教授
2022 年～2026 年 オルバイオ株式会社 代表取締役 CEO (最高経営責任者)
2026 年～現在 オルバイオ株式会社取締役 CVO (最高構想責任者)



(2) 『もはや待ったなし — エネルギー制約へ挑む BBCube™』

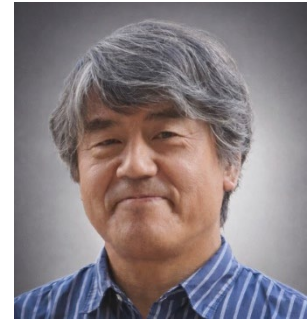
Large-Scale 3DI using WOW/COW Hybrid Processes』

講師：東京科学大学 大場隆之氏

概要：国際情勢の不安定化により、エネルギー供給は容易に地政学的な取引材料へと転落し、ホルムズ海峡の一挙手一投足が社会インフラの生命線を左右する時代となった。一方、AI の爆発的普及によって大規模データセンターの電力需要は加速度的に膨張し、もはや「エネルギー枯渇」が半導体産業の成長を直接制約する段階に突入している。こうした危機に対し、WOW アライアンスが開発する BBCube 3D は、エネルギー問題に正面から挑む次世代 3D 集積技術である。WOW と COW を組み合わせたハイブリッドプロセス、さらに Via-Last 方式によるバンプレス TSV により、テラバイト級帯域と劇的な低消費電力を同時に達成する。ウエハ間を 10 μm で直結することで電気抵抗・熱抵抗を極限まで抑え、高密度・高信頼の多段積層を可能にする。本技術は、高性能・小型・低消費電力・低コストという三次元システムの究極形を目指している。

講師略歴：

1984 年富士通(株)、2004 年東京大学、2013 年東京工業大学、2024 年東京科学大学特任教授、現在に至る。台湾國立陽明交通大學客員教授、三次元積層大規模集積技術および冷却技術など超低消費電力システムの研究開発に従事。東京工業大学 WOW アライアンスを主宰。1995 年東北大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。



(3) 『Green Innovation, Sustainable Growth ～半導体の未来に向けた Winbond の ESG 戦略』

講師：ウインボンドエレクトロニクス(株) 矢野勝氏

概要：AI、自動車、IoT、クラウドサービスの拡大に伴い、半導体産業は社会のデジタル化を支える重要な基盤となっている。その一方で気候変動への対応、サプライチェーン全体での脱炭素化、人権・コンプライアンスへの取り組みなど、企業にはこれまで以上に高い ESG 対応が求められている。とりわけ近年は、各国政府による脱炭素政策や情報開示規制の強化に加え、グローバル顧客やサプライチェーンからの要求も急速に高まっている。ESG への対応はもはや企業の社会貢献活動ではなく、国家政策・顧客要求・サプライチェーン要請に応える経営戦略そのものとなっている。Winbond も台湾政府の 2050 年ネットゼロ政策や国際的なサステナビリティ要請を踏まえ、再生可能エネルギーの活用、グリーン製品開発、環境負荷低減、持続可能なサプライチェーン構築などを推進している。本講演では、半導体業界を取り巻く ESG 動向と政策的背景を概観するとともに、Winbond の具体的な取り組みを紹介する。技術革新と持続可能性の両立を目指す「Green Innovation」を通じて、Winbond がどのように企業価値と社会価値を創出し、半導体産業の持続可能な未来に貢献していくのかを考察する。

講師略歴：

大手半導体メーカーにて NOR 型・NAND 型フラッシュメモリ設計開発に従事。2010 年ウインボンド・エレクトロニクス株式会社へ入社。NAND フラッシュ製品設計部門の統括部長を経て、現在はマーケティング部統括部長として DRAM、フラッシュ製品のプロモーション、商品企画および顧客サポートを担当



(4) 『半導体製造工場の安全、防災を含む BCM 取組と BCP 対策』

講師：キオクシア(株) 池内徹氏

概要：南海トラフ地震などの大規模地震、台風や豪雨などの風水害など各種災害、電気火災などの火災事故が懸念される中、改めて、BCP (Business Continuity Plan: 事業継続計画) の取組が注目され、想定されるビジネスリスクに対して事業継続計画を立案、教育や訓練を含め各種リスク低減施策が推進されている。今回、経営リスク、災害や事故リスクなど事業継続リスク低減を推進している BCM (Business Continuity Management: 事業継続マネジメント) の取組、半導体製造工場で働かれている大勢の方々の人命保護、教育や訓練、リスク低減施策ならびに今後の検討課題について紹介する。

講師略歴：

1985 年 (株)東芝 北九州工場に入社、生産技術部にて装置技術業務に従事
2012 年 加賀東芝エレクトロニクス(株)に出向、プロセス生産技術部、
ファクトリー生産技術部にて生産技術業務に従事
2016 年 (株)東芝 四日市工場に復職、第三生産技術部にて装置技術業務に従事
2019 年 10 月 社名をキオクシア(株)に変更
2020 年 キオクシア(株) 四日市工場 企画部にて BCM/BCP 業務に従事



(5) 『インド市場の具体的進出方法、「SEMICON India 2026」報告』

講師：NPO 法人 日印ビジネスビューロー／日印半導体コミッティー (JISC) 安井重磨、穂谷宜親氏
概要：インド政府は半導体を国家戦略産業と位置づけ、日本企業への期待がかつてなく高まっている。本講演ではインド市場への具体的な進出方法を二部構成で紹介する。前半 (安井) では ISM、IESA、CII、Invest India、およびウツタル・プラデーシュ州をはじめ半導体産業に注力する各州の支援のもとで運営される「常設展示会場」を解説する。会場ではコンシェルジュが常駐して日本企業の製品を紹介するほか、年間を通じてイベントを開催しており、支援機関による集客に加え、インド企業の要望を日本企業が解決するミッションも行っている。後半 (穂谷) では、SEMICON India 2026 の状況を、昨年度と今年度の訪問で感じた違いやインド全体の動きを踏まえ、2 年間を通しての所感とともに写真を交えて報告する。インド進出をご検討中の企業にはコンサルティング、マーケティング、プロモーションの具体的なご提案が可能である。ご興味のある方はぜひご相談いただきたい。インド政府・関係協会とともに課題を解決していく。

講師略歴：

安井重磨 (やすい しげまる)：NPO 法人 日印ビジネスビューロー (JIBB) CEO / 日印半導体コミッティー(JISC) CEO / 日印コンサルティング 株式会社 (JIC) 代表取締役。日印間の半導体ビジネス交流を推進し、インドにおける日本企業向け常設展示会場の運営、進出支援コンサルティング等を手がける。



穂谷宜親 (あきや のぶちか)：日印半導体コミッティー (JISC) エグゼクティブディレクター。インド半導体市場の現地調査および日印企業間の連携支援を担当。



5. 参加費

今年からできるだけ多くの方に興味を持っていただけるように講演件数を 4 件以上に増やし、それに伴って、SSIS 会員 (個人会員・準会員・賛助会員) の聴講料を 2,000 円/人、DAFS 会員企業の社員の聴講料を 4,000 円/人、一般の方の聴講料を 8,000 円/人とさせていただきます。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。なお、懇親会は 3,000 円/人に据え置きと致します。

- 会員・準会員・賛助会員：講演聴講：2,000 円/人、 懇親会：3,000 円/人
(注：70 歳以上の個人会員は聴講費無料)
- DAFS 会員企業の社員：講演聴講：4,000 円/人、 懇親会：3,000 円/人
- 一般： 講演聴講：8,000 円/人、 懇親会：3,000 円/人

6. 申し込み方法

- ・ 申し込み締め切り：2026 年 9 月 7 日 (月) 17：00
- ・ 申し込み先：info@ssis.or.jp
- ・ 本メールに返信の形で事務局 (info@ssis.or.jp) まで申し込みください。

【氏名】 _____ 【ご所属】 _____

(注) お申込者の氏名、所属については請求書、領収書の発行時の宛先となりますので、ご了承ください。

【領収書】

() 領収書を希望する () 領収書は不要

【SSIS 会員、DAFS 会員、一般】

() SSIS 会員、 () DAFS 会員【会社名： _____】、 () 一般

【フォーラム】

() 林野会館で参加 () リモートで参加

【懇親会】

() 参加 () 不参加

7. 請求書・領収書について

- ・ 申し込み頂きましたら、SSIS の銀行口座を記載した請求書をお送りいたしますので、申し込んだ方 (SSIS 会員、DAFS 会員、一般の方とも) はフォーラム参加費と懇親会参加費 (懇親会参加希望者) をお振り込みください。
- ・ 請求書の宛先は、上記 6 項でご入力いただいたご氏名、ご所属となります。
- ・ ご入金を確認されましたら希望者には領収書を発行いたします。上記 6.【領収書】の項目にチェックを入れてください。

宛先は請求書と同じになります。なお、領収書の再発行はできかねますのでご了承ください。

また、但し書きは『SSIS 2026 年度第 3 回フォーラム聴講費及び懇親会参加費』となります。

懇親会に参加されない方につきましては『2026 年度 SSIS 第 3 回フォーラム聴講費』となります。

但し書きにつきまして、ご指定がございましたら下記にご記入ください。

但し書き： _____

8. その他

- ・ オンラインで参加を希望される方には、開催 1 週間前をめどに、フォーラム参加費の振り込みを確認の上、オンライン接続情報 (Zoom) をお送りします。

- ・お申し込みをキャンセルされる場合は、申込期限までをお願い致します。期限を過ぎた場合には、返金致しかねますのでご理解、ご了承をお願い致します。
- ・ご質問がある場合は、事務局 (info@ssis.or.jp) までお問い合わせください。

一般社団法人 半導体産業人協会

<https://www.ssis.or.jp>

TEL : 03-6457-3245

FAX : 03-6457-3246
